

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 2 日 (02.06.2005)

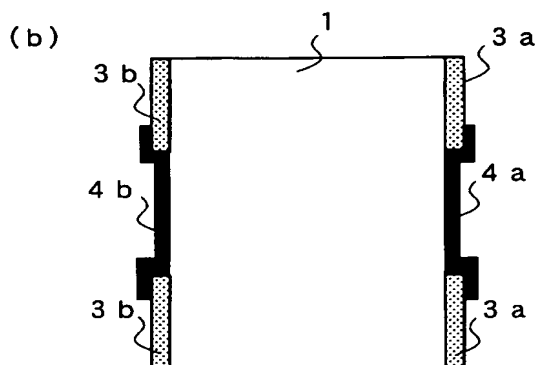
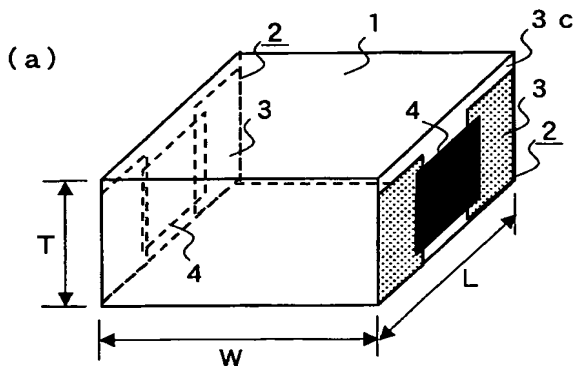
PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/050677 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H01C 7/00
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/016828
- (22) 国際出願日: 2004 年 11 月 12 日 (12.11.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2003-387948
2003 年 11 月 18 日 (18.11.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 箕輪興亜株式会社 (MINOWA KOA INC.) [JP/JP]; 〒3994601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 1 4 0 1 6 番 3 0 号 Nagano (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤本 浩治 (FUJIMOTO, Koji) [JP/JP]; 〒3994601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 1 4 0 1 6 番 3 0 号 箕輪興亜株式会社内 Nagano (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, [続葉有])

(54) Title: SURFACE MOUNT COMPOSITE ELECTRONIC COMPONENT AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: 表面実装型複合電子部品及びその製造法



(57) Abstract: Disclosed is a surface mount composite electronic component which can be small-sized. Such a surface mount composite electronic component has a structure wherein a circuit device (2) is respectively formed on a pair of opposing surfaces of an insulating substrate (1) which is composed of a hexahedron, and an electrode (3) of the circuit device (2) also serves as an external terminal. The surface mount composite electronic component comprises, for example, a pair of first electrodes (1a) arranged on both ends of the front surface of the hexahedral insulating substrate (1), a pair of second electrodes (1b) arranged on the rear surface of the insulating substrate so that they are opposite to the first electrodes (1a), a first resistor (4a) arranged in contact with both of the first electrodes (1a), and a second resistor (4b) arranged in contact with both of the second electrodes (1b).

(57) 要約: 小型化が可能な表面実装型複合電子部品を提供する。そのための表面実装型複合電子部品の構造は、六面体からなる絶縁基板 (1) の一組の向い合う面に夫々一つ回路素子 (2) が形成される表面実装型複合電子部品であって、当該回路素子 (2) を構成する電極 (3) が、外部端子を兼ねる。例えば六面体からなる絶縁基板 (1) 表面の両端に配置された一対の第 1 電極 (1a) と、当該絶縁基板の裏面に前記第 1 電極 (1a) と対向するように配置された一対の第 2 電極 (1b) と、前記一対の第 1 電極 (1a) 双方に接触するよう配置された第 1 の抵抗体 (4a) と、第 2 電極 (1b) 双方に接触するよう配置された第 2 の抵抗体 (4b) を有する。



KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

規則4.17に規定する申立て:

- USのための発明者である旨の申立て (規則4.17(iv))

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。